

# 第 1 1 1 回型技術セミナー

## モノづくりの工法が変えられるか 3D プリンター

◆開催日時：2013年10月28日(月) 10:00～16:55

◆開催場所：芝浦工業大学 芝浦キャンパス

〒108-8548 東京都港区芝浦3-9-14

◆主催：(社)型技術協会 (企画：新加工技術研究委員会)

◆協賛：(社)日本金型工業会

◆趣旨：

モノづくりのグローバル化が進行するなかで、モノづくりの工法が変えられないかという動きがある。これが最近話題になっている3Dプリンターの活用である。3Dプリンター技術も日本以外のアメリカや欧州などでは、鑄造金型製作を始めとしてモノづくり分野で新たなモノづくり工法として注目され、技術開発、実用化も盛んに行われてきている。日本でも2、3年前から3Dプリンター技術の見直しと技術を生かすための新たな技術開発が始まっている。それに火をつけたのが、経済産業省が中心になって開発をしている、複雑形状の砂型を製作できる3次元プリンターです。勿論、これ以外にも金属材料、非鉄金属材料など、プラスチック材料以外の材料を造形するためのレーザー焼結積層造形法や電子ビーム積層造形法などが最近脚光を浴び始めています。

本型技術セミナーでは、3Dプリンターでモノづくり工法が変えられるかなど新たなモノづくりを探るため、3Dプリンターの現状実力と将来について研究開発を行っている方々と、実際3Dプリンターを使い金型などモノづくりを行っている方々に講演をお願いすることにしました。

◆講演者：(講演順)

司会：東京工科大学 福井 雅彦氏、電気通信大学 森重 功一氏

展望・開発状況紹介

10:00～11:00 「付加製造技術(3Dプリンター)の現状と展望」 東京大学 新野 俊樹氏

11:00～12:00 「電子ビーム積層造形技術による金属系構造部材の創製」  
東北大学 千葉 晶彦氏

12:00～13:00 昼食

13:00～13:45 「レーザー積層造形法を用いた金属部品の製造技術」  
(独)産業技術総合研究所 中野 禅氏

事例紹介1

13:45～15:15 「レーザと切削を融合した積層造形による金型づくり」  
パナソニック(株) 吉田 徳雄氏  
(株)OPM ラボラトリー 森本 一穂氏

15:15～15:25 休憩

事例紹介2

15:25～16:10 「3Dプリンター受託ビジネスと鑄造」(株)ジェイ・エム・シー 渡邊 大知氏

16:10～16:55 「レーザ積層造形法での医療部品などへの活用事例紹介」  
(株)NTT データエンジニアリングシステムズ 前田 寿彦氏

◆参加費：いずれもテキスト1冊を含む

会 員 20,000 円（会員の対象は主催・協賛団体会員です）

型技術協会学生会員 1,000 円

一 般 30,000 円

※個人会員A入会申込付き 30,875 円（ご希望の方は事務局までお問い合わせ下さい）

内訳：参加費 20,000 円＋入会金 3,000 円＋9 月入会時年会費 7,875 円

◆募集人数：50名

◆申込締切：10月21日（月）

※申込締切日後のキャンセルはできません。参加費をお支払いいただきます。

◆申込方法：ホームページよりオンライン申込(<http://www.jsdmt.jp/>)

1) お申込の際は、代金の振込方法と振込日をご記入下さい。

参加費は銀行または郵便振替にてご入金下さい。

2) 参加決定者には参加券・請求書をお送りいたします。

当日参加券と引換にテキストをお渡し致しますのでご持参下さい。

◆問 合 先：一般社団法人 型技術協会

〒231-0011 横浜市中区太田町 6-79 アブソルート横濱馬車道ビル 201 号室

TEL：045-224-6081 FAX：045-224-6082 E-mail：info@jsdmt.jp